

# 野村世界業種別投資シリーズ (世界半導体株投資)

## 運用報告書(全体版)

第15期（決算日2024年6月28日）

作成対象期間（2023年6月29日～2024年6月28日）

### 受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。  
当作成対象期間の運用状況等についてご報告申し上げます。  
なお、当ファンドは、2023年9月27日に信託期間を無期限とする約款変更を行ないましたので、ご留意下さい。  
今後とも一層のお引立てを賜りますよう、お願い申し上げます。

### ●当ファンドの仕組みは次の通りです。

商品分類	追加型投信／内外／株式
信託期間	2009年8月27日以降、無期限とします。
運用方針	世界各国の半導体関連企業の株式を主要投資対象とし、信託財産の成長を目標に積極的な運用を行なうことを基本とします。株式への投資にあたっては、定量分析により銘柄群の絞込みを行なった後、トップダウン・アプローチによる各国・地域のマクロ投資環境見通しを考慮しつつ、技術力、価格決定力、利益構造、財務内容などの観点からファンダメンタルズ分析を行ない、組入銘柄を決定します。また、個別銘柄評価とポートフォリオ全体のリスク特性などを総合的に勘案し、ポートフォリオを構築します。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
主な投資対象	世界各国の半導体関連企業の株式を主要投資対象とします。
主な投資制限	株式への投資割合には制限を設けません。 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
分配方針	毎決算時に、原則として経費控除後の繰越分を含めた配当等収益と売買益等から、基準価額水準等を勘案して分配します。留保益の運用については、特に制限を設けず、元本部分と同一の運用を行ないます。

## 野村アセットマネジメント

東京都江東区豊洲二丁目2番1号



サポートダイヤル 0120-753104

〈受付時間〉 営業日の午前9時～午後5時



ホームページ <http://www.nomura-am.co.jp/>

## ○最近5期の運用実績

決算期	基準価額 (分配落)	基準価額		ベンチマーク		株組入比率	株先物比率	純資産額
		税込み	分配金	騰落率	騰落率			
	円	円	%	%	%	%	百万円	
11期(2020年6月29日)	37,651	1,450	32.3	37.7	99.3	—	18,164	
12期(2021年6月28日)	62,327	2,800	73.0	76.1	97.8	—	28,699	
13期(2022年6月28日)	60,702	2,650	1.6	2.3	97.6	—	33,153	
14期(2023年6月28日)	91,149	4,350	57.3	51.1	98.7	—	73,864	
15期(2024年6月28日)	175,535	9,000	102.5	106.6	98.6	—	419,208	

\*基準価額の騰落率は分配金込み。

\*株式先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

\*ベンチマーク（=MSCI All Country World Semiconductors & Semiconductor Equipment（税引後配当込み・円換算ベース）は、MSCI All Country World Semiconductors & Semiconductor Equipment（税引後配当込み・ドルベース）をもとに、当社が独自に円換算したものです。  
\*MSCI All Country World Semiconductors & Semiconductor Equipment（税引後配当込み・ドルベース）は、MSCIが開発した指数で、同指数の著作権、知的所有権その他一切の権利はMSCIに帰属します。またMSCIは、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。  
(出所) MSCI、ブルームバーグ

## ○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額	ベンチマーク		株組入比率	株先物比率
		騰落率	騰落率		
(期首) 2023年6月28日	円 91,149	% —	% —	% 98.7	% —
6月末	90,870	△ 0.3	0.4	95.6	—
7月末	95,114	4.4	4.1	98.2	—
8月末	96,122	5.5	5.1	98.6	—
9月末	90,510	△ 0.7	△ 1.3	96.2	—
10月末	86,946	△ 4.6	△ 5.1	98.6	—
11月末	100,254	10.0	9.2	97.9	—
12月末	105,530	15.8	15.2	98.3	—
2024年1月末	118,399	29.9	30.4	97.8	—
2月末	135,432	48.6	49.1	98.1	—
3月末	148,271	62.7	63.4	98.4	—
4月末	147,250	61.5	63.5	98.9	—
5月末	165,641	81.7	85.5	97.5	—
(期末) 2024年6月28日	184,535	102.5	106.6	98.6	—

\*期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

\*株式先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

## ◎運用経過

### ○期中の基準価額等の推移



期 首：91,149円

期 末：175,535円（既払分配金（税込み）：9,000円）

騰落率：102.5%（分配金再投資ベース）

- (注) 分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。作成期首（2023年6月28日）の値が基準価額と同一となるように指数化しております。
- (注) 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、個々のお客様の損益の状況を示すものではありません。
- (注) ベンチマークは、MSCI All Country World Semiconductors & Semiconductor Equipment（税引後配当込み・円換算ベース）です。ベンチマークは、作成期首（2023年6月28日）の値が基準価額と同一となるように計算しております。
- (注) 上記騰落率は、小数点以下第2位を四捨五入して表示しております。

### ○基準価額の主な変動要因

- (横ばい) 米半導体製造装置メーカーが2023年4-6月期の決算発表において2023年の市場見通しを引き上げたこと、為替市場で米ドル高・円安が進行したこと、一方、中国景気の低迷が懸念されたこと、米下院議長選挙での選出遅れによる混乱が懸念されたこと、米長期金利が上昇したこと
- (上 昇) 7-9月期の米企業決算において市場予想を上回る決算が相次いだこと、10月の米CPI（消費者物価指数）上昇率が市場予想を下回ったこと、AI半導体市場拡大への期待が高まったこと、PCやスマートフォン向け半導体の在庫処理が概ね終了したとの見方が広がったこと、2024年の米政策金利について3回の利下げ見通しが維持されたこと、米長期金利が低下したこと
- (上 昇) 米国の大手ソフトウェア会社がAI機能を大幅に強化したPCを発表し、高性能半導体の需要増加への期待が高まったこと、オランダの半導体製造装置メーカーが最新鋭機器を台湾の大手半導体メーカーへ納入する見通しを示したことが好感されたこと、為替市場で米ドル高・円安が進行したこと

## ○投資環境

当期の世界の半導体・半導体製造装置株は、米半導体製造装置メーカーが2023年4-6月期の決算発表において2023年の市場見通しを引き上げたことなどが好感され上昇する一方、中国景気の低迷や、米下院議長選挙での選出遅れによる混乱などが懸念され下落するなど、10月にかけてほぼ変わらずとなりました。

11月に入ると、7-9月期の米企業決算において市場予想を上回る決算が相次いだことや、10月の米CPI上昇率が市場予想を下回ったことなどが好感され上昇し、その後も、AI半導体市場拡大への期待感の高まりに加えて、PCやスマートフォン向け半導体の在庫処理が概ね終了したとの見方が広がったこと、2024年の米政策金利について3回の利下げ見通しが維持されたことなどが好感され、2024年3月にかけて上昇基調を維持しました。

4月には、FOMC（米連邦公開市場委員会）メンバーであるリッチモンド連銀のバーキン総裁がインフレ抑制に関して時間をかけて対応することが賢明だとして早期の利下げ期待が後退したことや、中国当局が国内の主要通信事業者に対して外国製半導体の使用を段階的に排除するよう指示していたとの報道などが嫌気され、反落しました。

期末にかけては、米国の大手ソフトウェア会社がAI機能を大幅に強化したPCを発表し、高性能半導体の需要増加への期待が高まったことや、オランダの半導体製造装置メーカーが最新鋭機器を台湾の大手半導体メーカーへ納入する見通しを示したことなどが好感され上昇し、当期において世界の半導体・半導体製造装置株は大幅な上昇となりました。

一方、為替市場では、2023年11月中旬にかけて、FRB（米連邦準備制度理事会）の金融引き締め継続観測などから日米金利差が拡大し米ドル高・円安が進行しました。その後、12月にかけて、FRBの早期利下げ期待の高まりなどにより日米金利差が縮小し米ドル安・円高が進行しましたが、期末にかけては、FRBの早期利下げ期待が後退したことや、日銀が緩和的な金融政策を維持する見通しを示したことなどを背景に再び日米金利差の拡大期待が高まったことで米ドル高・円安が進行し、当期において米ドル高・円安となりました。

## ○当ファンドのポートフォリオ

### ・株式組入比率

期を通じておおむね高位を維持しました。

### ・期中の主な動き

- (1) 地域・国別配分では、米国をオーバーウェイト（ベンチマークに比べ高めの投資比率）としました。一方、台湾、日本などをアンダーウェイト（ベンチマークに比べ低めの投資比率）、フランス、中国などを非保有としました。
- (2) 個別銘柄では、エヌビディア（米国）、ブロードコム（米国）、台湾セミコンダクター（台湾）などを上位に組み入れました。
- (3) 為替につきましては、ヘッジ（為替の売り予約）は行ないませんでした。

## ○当ファンドのベンチマークとの差異

ベンチマーク（MSCI All Country World Semiconductors & Semiconductor Equipment（税引後配当込み・円換算ベース））が106.6%の上昇となったのに対して、基準価額は102.5%の上昇となりました。

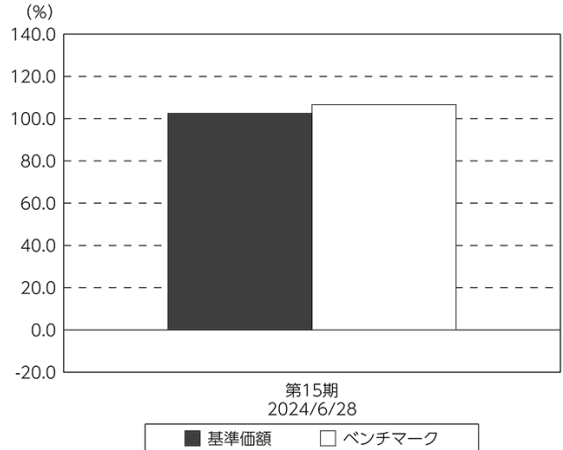
### （主なプラス要因）

- ①地域・国別配分で、株価騰落率がベンチマークを下回った中国などを非保有としたこと
- ②個別銘柄において、株価騰落率がベンチマークを下回ったテキサス・インスツルメンツ（米国）などをアンダーウェイトとしたこと

### （主なマイナス要因）

- ①個別銘柄において、株価騰落率がベンチマークを上回ったエヌビディア（米国）などをアンダーウェイトとしたことや、株価騰落率がベンチマークを下回ったエンフェーズ・エナジー（米国）などをオーバーウェイトとしたこと

基準価額とベンチマークの対比（期別騰落率）



(注) 基準価額の騰落率は分配金込みです。

(注) ベンチマークは、MSCI All Country World Semiconductors & Semiconductor Equipment（税引後配当込み・円換算ベース）です。

## ◎分配金

今期の収益分配金については、基準価額水準等を勘案し、1万口当たり9,000円とさせていただきます。留保益の運用については、特に制限を設けず、元本部分と同一の運用を行いません。

## ○分配原資の内訳

（単位：円、1万口当たり・税込み）

項目	第15期
	2023年6月29日～ 2024年6月28日
当期分配金	9,000
（対基準価額比率）	4.877%
当期の収益	9,000
当期の収益以外	—
翌期繰越分配対象額	165,535

(注) 対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。

(注) 当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。

## ◎今後の運用方針

### ・投資環境

- (1) 米国経済は、堅調に推移しています。5月の非農業部門雇用者数は前月差+27.2万人となり4月から大きく増加し、賃金の伸び率も高水準にあります。一方、インフレ率は鈍化傾向にあるものの引き続き高く、FRBは、利下げを急ぐ必要はないとのスタンスです。今後の景気・物価が上振れする場合には、市場想定よりも利下げ時期が後ずれする可能性もあり注視が必要です。
- (2) 欧州経済は、6月のユーロ圏総合PMI（購買担当者景気指数）速報値は4ヵ月連続で景気判断の基準となる50を上回ったものの5月からは低下し、景気持ち直しのペースにはやや鈍化傾向がみられました。また、インフレが中期的に落ち着くとの判断もあり、ECB（欧州中央銀行）は利下げを実施しました。今後も、景気や物価の動向がECBの金融政策へどのような影響を与えるのか注視が必要です。

### ・運用方針

- (1) 当ファンドはボトムアップアプローチを重視し、技術力、価格決定力、利益構造、財務内容などの観点から、グローバルに半導体・半導体製造装置市場をリードしていくことができる企業群に投資します。ファンドのポートフォリオ構築にあたっては、地域・国別配分、業種別配分ともに市場の時価総額構成比を意識した配分を行ない、世界の半導体関連株市場全体の動きを反映したリターンの獲得を目指します。
- (2) 銘柄選択においては、中長期的な成長が見込まれる分野として、AI用途向けの半導体や、通信（インフラ）用半導体、先進運転システム向け半導体などが有望だと考えています。また、AI機能を搭載したスマートフォンやPCが今後相次いで市場に投入されることからこれらの製品に使われる低消費電力かつ高性能な半導体に注目しています。なお、減速感が強まっていた自動車や産業機械向け半導体などについては、積み上がった在庫の調整にどれくらいの期間が必要なのか精査しています。これら需要先の動向が半導体各社の業績に与える影響を考慮しながら銘柄選択を行ないます。
- (3) 当面の運用方針としては、収益性や競争力の高い銘柄を中心に、今後の成長力とバリュエーション（投資価値評価）のバランスに配慮したポートフォリオ構築を行なう方針です。

今後とも、引き続きご愛顧を賜りますよう、よろしくお願いいたします。

## ○ 1 万口当たりの費用明細

（2023年6月29日～2024年6月28日）

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円 1,898	% 1.650	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
（ 投 信 会 社 ）	( 905)	(0.787)	ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等
（ 販 売 会 社 ）	( 905)	(0.786)	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等
（ 受 託 会 社 ）	( 89)	(0.077)	ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等
(b) 売 買 委 託 手 数 料	160	0.139	(b) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
（ 株 式 ）	( 160)	(0.139)	
(c) 有 価 証 券 取 引 税	8	0.007	(c) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 ※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
（ 株 式 ）	( 8)	(0.007)	
(d) そ の 他 費 用	17	0.015	(d) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
（ 保 管 費 用 ）	( 13)	(0.011)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
（ 監 査 費 用 ）	( 4)	(0.004)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
（ そ の 他 ）	( 0)	(0.000)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	2,083	1.811	
期中の平均基準価額は、115,028円です。			

\* 期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。

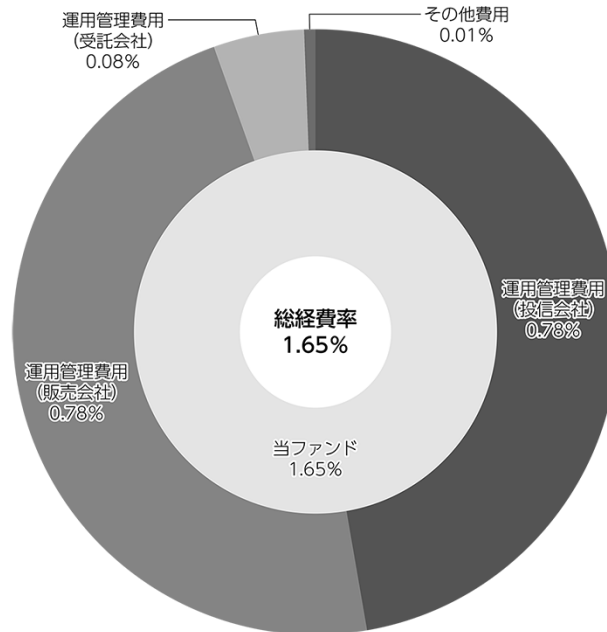
\* 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

\* 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

## （参考情報）

## ○総経費率

当期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（1口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は1.65%です。



(注) 当ファンドの費用は1万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。

(注) 各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を含みません。

(注) 各比率は、年率換算した値です。

(注) 当ファンドのその他費用には、外貨建資産の保管等に要する費用、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用、信託事務の処理に要するその他の諸費用等が含まれます。

(注) 上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。



## ○売買及び取引の状況

(2023年6月29日～2024年6月28日)

## 株式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
国内	上場	千株 293	千円 8,698,355	千株 199	千円 7,053,810
	アメリカ	百株 67,355 (55,132)	千米ドル 986,674 ( )	百株 35,570	千米ドル 168,011
外国	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	ドイツ	2,961	11,119	3,475	11,851
	オランダ	1,260	78,589	31	1,770
	韓国	5,411	千ウォン 114,517,911	—	千ウォン —
	台湾	81,570	千新台幣ドル 8,113,076	2,050	千新台幣ドル 692,355

\*金額は受け渡し代金。

\*単位未満は切り捨て。

\* ( ) 内は株式分割、予約権行使、合併等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

## ○株式売買比率

(2023年6月29日～2024年6月28日)

## 株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項 目	当 期
(a) 期中の株式売買金額	263,288,039千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	180,249,376千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	1.46

\*(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

## ○利害関係人との取引状況等

(2023年6月29日～2024年6月28日)

## 利害関係人との取引状況

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
株式	百万円 225,033	百万円 475	% 0.2	百万円 38,254	百万円 7,053	% 18.4

## 売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

項 目	当 期
売買委託手数料総額 (A)	212,408千円
うち利害関係人への支払額 (B)	3,728千円
(B) / (A)	1.8%

利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当ファンドに係る利害関係人とは野村證券株式会社です。

## ○組入資産の明細

(2024年6月28日現在)

## 国内株式

銘 柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
電気機器 (100.0%) 東京エレクトロン		千株	千株	千円
	49.5		143.5	5,008,150
合 計	株 数 ・ 金 額	49.5	143.5	5,008,150
	銘 柄 数 < 比 率 >	1	1	< 1.2% >

\*各銘柄の業種分類は、期首、期末の各時点での分類に基づいています。

\*銘柄欄の( )内は、国内株式の評価総額に対する各業種の比率。

\*評価額欄の< >内は、純資産総額に対する評価額の比率。

\*評価額の単位未満は切り捨て。

## 外国株式

銘 柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
ADVANCED MICRO DEVICES	1,475	1,287	20,534	3,307,436	半導体・半導体製造装置
ANALOG DEVICES INC	129	32	728	117,274	半導体・半導体製造装置
APPLIED MATERIALS	1,990	6,189	143,935	23,183,707	半導体・半導体製造装置
BROADCOM INC	478	2,000	317,450	51,131,832	半導体・半導体製造装置
ENPHASE ENERGY INC	873	76	799	128,815	半導体・半導体製造装置
INTEL CORP	8,805	381	1,166	187,960	半導体・半導体製造装置
KLA CORP	449	1,419	115,709	18,637,263	半導体・半導体製造装置
LAM RESEARCH	378	492	51,967	8,370,478	半導体・半導体製造装置
MARVELL TECHNOLOGY INC	3,171	14,236	97,850	15,760,822	半導体・半導体製造装置
MICROCHIP TECHNOLOGY	178	6,179	55,265	8,901,629	半導体・半導体製造装置
MICRON TECHNOLOGY	3,271	9,478	125,329	20,186,835	半導体・半導体製造装置
NVIDIA CORP	3,160	61,258	759,547	122,340,374	半導体・半導体製造装置
ON SEMICONDUCTOR CORPORATION	248	1,297	8,803	1,417,921	半導体・半導体製造装置
QUALCOMM INC	2,455	7,478	145,940	23,506,618	半導体・半導体製造装置
TEXAS INSTRUMENTS INC	490	2,763	53,461	8,610,987	半導体・半導体製造装置
NXP SEMICONDUCTORS NV	130	29	768	123,786	半導体・半導体製造装置
小 計	株 数 ・ 金 額	27,684	114,602	1,899,259	305,913,744
	銘 柄 数 < 比 率 >	16	16	—	< 73.0% >

銘柄	期首(前期末)	当 期		業 種 等	
		株 数	株 数		評 価 額
				外貨建金額	邦貨換算金額
				千ユーロ	千円
(ユーロ…ドイツ)		百株	百株		
INFINEON TECHNOLOGIES AG		629	116	394	68,064
小 計	株 数 ・ 金 額	629	116	394	68,064
	銘柄 数 < 比 率 >	1	1	—	<0.0%>
(ユーロ…オランダ)					
ASM INTERNATIONAL NV		353	1,268	88,780	15,299,509
ASML HOLDING NV		370	684	65,750	11,330,766
小 計	株 数 ・ 金 額	723	1,953	154,530	26,630,275
	銘柄 数 < 比 率 >	2	2	—	<6.4%>
ユ ー ロ 計	株 数 ・ 金 額	1,353	2,069	154,925	26,698,339
	銘柄 数 < 比 率 >	3	3	—	<6.4%>
(韓国)				千ウォン	
SK HYNIX INC		427	5,839	138,100,864	16,074,940
小 計	株 数 ・ 金 額	427	5,839	138,100,864	16,074,940
	銘柄 数 < 比 率 >	1	1	—	<3.8%>
(台湾)				千新台幣ドル	
MEDIATEK INC		710	17,620	2,457,990	12,153,777
TAIWAN SEMICONDUCTOR		29,590	90,260	8,664,960	42,844,761
ASPEED TECHNOLOGY INC		—	1,940	931,200	4,604,411
小 計	株 数 ・ 金 額	30,300	109,820	12,054,150	59,602,950
	銘柄 数 < 比 率 >	2	3	—	<14.2%>
合 計	株 数 ・ 金 額	59,766	232,331	—	408,289,974
	銘柄 数 < 比 率 >	22	23	—	<97.4%>

\* 邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

\* 邦貨換算金額欄の< >内は、純資産総額に対する各国別株式評価額の比率。

\* 株数・評価額の単位未満は切り捨て。

\* 銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

## ○投資信託財産の構成

(2024年6月28日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
株式	413,298,124	93.0
コール・ローン等、その他	31,330,476	7.0
投資信託財産総額	444,628,600	100.0

\* 金額の単位未満は切り捨て。

\* 当期末における外貨建純資産（409,708,084千円）の投資信託財産総額（444,628,600千円）に対する比率は92.1%です。

\* 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1米ドル=161.07円、1スイスフラン=179.07円、1ユーロ=172.33円、1ウォン=0.1164円、1新台幣ドル=4.9446円。

## ○資産、負債、元本及び基準価額の状況（2024年6月28日現在）

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	447,846,665,167
コール・ローン等	31,025,771,508
株式(評価額)	413,298,124,544
未収入金	3,219,930,000
未収配当金	302,768,175
未収利息	70,940
(B) 負債	28,638,109,830
未払金	3,218,064,800
未払収益分配金	21,493,562,616
未払解約金	1,807,269,801
未払信託報酬	2,114,982,706
その他未払費用	4,229,907
(C) 純資産総額(A-B)	419,208,555,337
元本	23,881,736,241
次期繰越損益金	395,326,819,096
(D) 受益権総口数	23,881,736,241口
1万円当たり基準価額(C/D)	175,535円

(注) 期首元本額は8,103,731,154円、期中追加設定元本額は21,502,904,025円、期中一部解約元本額は5,724,898,938円、1口当たり純資産額は17.5535円です。

(注) 投資信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託する為に要する費用、支払金額696,698,530円。

## ○損益の状況（2023年6月29日～2024年6月28日）

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	1,402,848,242
受取配当金	1,407,133,610
受取利息	8,010,942
その他収益金	165,128
支払利息	△ 12,461,438
(B) 有価証券売買損益	139,996,123,455
売買益	161,997,701,921
売買損	△ 22,001,578,466
(C) 信託報酬等	△ 2,909,871,110
(D) 当期損益金(A+B+C)	138,489,100,587
(E) 前期繰越損益金	12,402,344,671
(F) 追加信託差損益金	265,928,936,454
(配当等相当額)	( 82,112,085,157)
(売買損益相当額)	( 183,816,851,297)
(G) 計(D+E+F)	416,820,381,712
(H) 収益分配金	△ 21,493,562,616
次期繰越損益金(G+H)	395,326,819,096
追加信託差損益金	265,928,936,454
(配当等相当額)	( 82,112,085,157)
(売買損益相当額)	( 183,816,851,297)
分配準備積立金	129,397,882,642

\*損益の状況の中で(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。

\*損益の状況の中で(C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。

\*損益の状況の中で(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

(注) 分配金の計算過程（2023年6月29日～2024年6月28日）は以下の通りです。

項 目	当 期
	2023年6月29日～ 2024年6月28日
a. 配当等収益(経費控除後)	1,374,040,518円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後)	137,115,060,069円
c. 信託約款に定める収益調整金	265,928,936,454円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	12,402,344,671円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	416,820,381,712円
f. 分配対象収益(1万円当たり)	174,535円
g. 分配金	21,493,562,616円
h. 分配金(1万円当たり)	9,000円

## ○分配金のお知らせ

1 万口当たり分配金（税込み）	9,000円
-----------------	--------

※分配落ち後の基準価額が個別元本と同額または上回る場合、分配金は全額普通分配金となります。

※分配前の基準価額が個別元本を上回り、分配後の基準価額が個別元本を下回る場合、分配金は個別元本を上回る部分が普通分配金、下回る部分が元本払戻金（特別分配金）となります。

※分配前の基準価額が個別元本と同額または下回る場合、分配金は全額元本払戻金（特別分配金）となります。

## ○お知らせ

信託期間を「2027年6月28日まで」から「無期限」に変更する所要の約款変更を行ないました。  
＜変更適用日：2023年9月27日＞

2024年11月5日より、ファンドの設定解約の申込締切時間は以下の記載のとおり変更となる予定です。

原則、午後3時30分までに、販売会社が受けた分を当日のお申込み分とします。

（販売会社によっては上記と異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。）